

# 《电子机械工程》专题征稿通知

## “电子装备精密制造及智能装配”专题

随着电子装备向“智能化、综合化、轻量化”方向不断发展，其结构复杂度、功率密度日趋增加，结构高复杂、装调高精度、机电强耦合的产品特性愈发突出，现有制造装配方法面临生产周期长、研制成本高且产品性能难以控制的问题，电子装备精密制造及智能装配技术的发展需求愈发迫切。

当前国内外精密制造技术、机器人智能化制造装配等技术已广泛应用于航空、航天、船舶等复杂产品制造过程中，但复杂电子装备产品目前仍以经验指导的手工操作作为主完成，因此，发展电子装备智能化制造装配技术对提高生产率和保障产品性能具有重要意义。

### 征稿方向（包括但不限于）：

- 1、复杂结构设计技术
- 2、复杂结构精密制造技术
- 3、电子装备智能装配技术
- 4、电子芯片散热技术
- 5、智能制造技术
- 6、机器人智能化制造技术
- 7、机器人智能化装配技术

### 专题主编：

田威	教授	南京航空航天大学
周金柱	教授	西安电子科技大学
庄存波	副研究员	北京理工大学
王长瑞	研究员	南京航空航天大学

### 征文要求：

- 1、征文论点明确、论述严谨、论据充分、图标清晰工整、尚未公开发表；
- 2、来稿必须由作者单位进行保密审查，需在投稿时向编辑部提交保密审查表（盖章原件）；
- 3、稿件字数应不少于5000字，采用Word排版；
- 4、稿件需包含题目、作者姓名及单位、摘要、关键词（通栏排，提供中英文）；引言、正文、结束语、参考文献、作者简介（双栏排），通信地址及联系方式附文末。

### 征稿日期：

截稿日期：2024年1月30日

出版日期：2024年第1期

### 投稿方式：

投稿请在《电子机械工程》网站（<http://dzjxgc.ijournals.cn>）“作者登录”处注册、上传，备注处注明：“电子装备精密制造及智能装配”专题投稿。

### 联系方式：

地址：南京市雨花台区国睿路8号《电子机械工程》编辑部

邮编：210039

联系人：汪老师 025-51821082、王老师 15952086703

E-mail: dzjxgc@126.com